

**USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Универсальная последовательная шина 2.0 и 3.0 (SuperSpeed); разъемы типа А соответствуют требованиям по высокому сопротивлению и обеспечивают надежное соединение.

- До 5000 циклов вставки
- Технология пайки THT, THR или SMD
- Предлагаются варианты конструкции 180° (вертикальная) или 90° (горизонтальная)
- Упаковка – лоток (TY) или рулон (лента на катушке, RL)
- Усиленный слой золота для повышения защиты от коррозии

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Данные OMNIMATE – штекер USB, розеточная колодка, 480 Мбит/с, Соединение THT/THR под пайку, 90°, Шаг в мм (P): 2.00 мм, Количество полюсов: 4, LCP, черный, Лоток (ручная сборка)
Номер для заказа	<a href="#">2563720000</a>
Тип	USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118572339
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Лоток (ручная сборка)

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:28:12 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	11,22 мм	Высота (в дюймах)	0,442 inch
Высота, мин.	7,12 мм	Глубина	14 мм
Глубина (дюймов)	0,551 inch	Масса нетто	0,001 g
Ширина	14,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,571 inch

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Упаковка**

Упаковка	Лоток (ручная сборка)	Длина VPE	0 м
VPE с	0 м	Высота VPE	0 м

**Системные характеристики**

Вид защиты	IP20	Вид соединения	Гнездо
Выводы для экранирования	нет	Длина контактного штифта (l)	1,4 мм
Категория эксплуатационных характеристик	480 Мбит/с	Количество контактных штырьков на полюс	1
Количество полюсов	4	Материал экрана	Латунь
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Поверхность экрана	никелированный
Светодиод	Нет	Серия изделия	Данные OMNIMATE – штекер USB
Скорость передачи	480 Мбит/с	Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную, Пайка волной припоя
Угол вывода	90°	Усилие вставки на полюс, макс.	35 N
Усилие вытягивания на полюс, макс.	10 N	Шаг в мм (P)	2 мм
Экранирование	Да		

**Электрические свойства**

Номинальное напряжение	30 V	Номинальный ток	1,5 A
Электрическая прочность, контакт / контакт	750 V AC		

**Данные о материалах**

Изоляционный материал	LCP	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	II
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	>= 500	Moisture Level (MSL)	1
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал контактов	Фосфористая бронза
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Структура слоев штепсельного контакта	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	60 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	60 °C

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Дата создания 11 апреля 2021 г. 13:28:12 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E471884

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
--------------------	----------------------

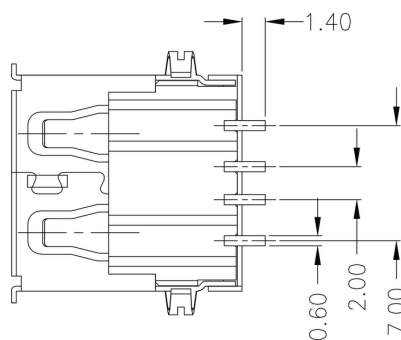
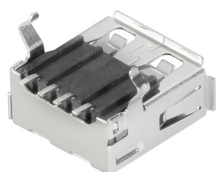
**USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

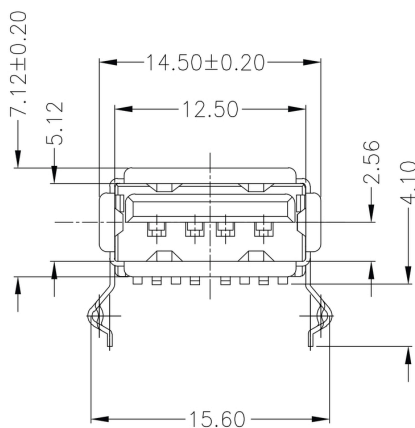
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

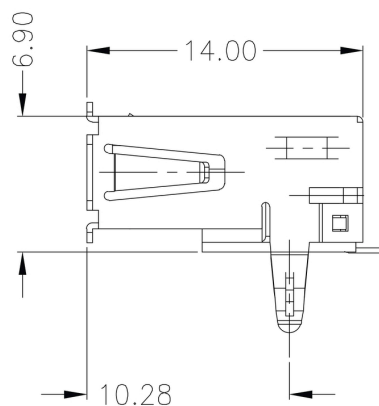
**Габаритный чертеж**



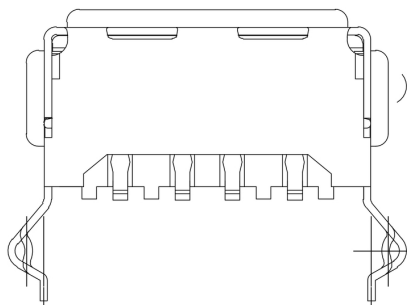
**Габаритный чертеж**



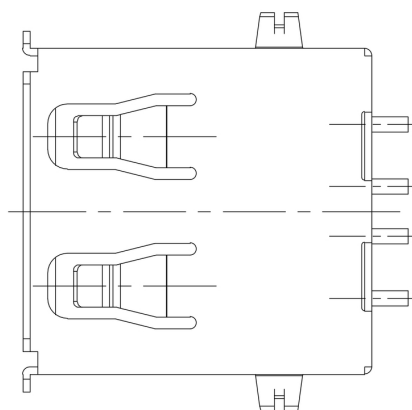
**Габаритный чертеж**



**Габаритный чертеж**



**Габаритный чертеж**



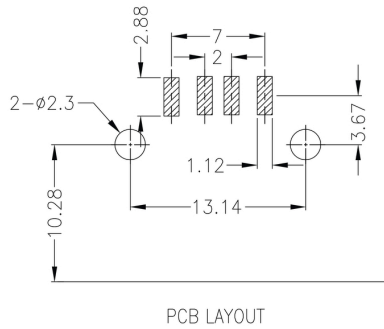
**USB2.0A S1H 1.4N4 TY BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж PCB платы**





## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klängenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



### Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.